



新器件及封装创新团队国际研讨会召开

文章来源: 微电子研究所

发布时间: 2010-03-26

【字号: 小 中 大】



为加强国际交流和促进我国半导体集成电路的发展, 3月22日, 由中国科学院微电子所联合微系统所共同成立的“新器件及封装”创新团队在微电子所举行国际研讨会。

微电子所所长叶甜春出席会议并致开幕词。来自国立交通大学的Albert CHIN博士, IBM的 Subramanian S. IYER博士和 Stuart P. PARKIN博士, Micronix 的 Rich LIU博士受邀分别作国际交流特别讲演。创新团队成员朱慧珑博士, 闫江博士, 钟汇才博士, 尹海洲博士, 骆志炯博士, 梁擎擎博士, 刘明博士, 刘致为博士及研究所相关领域研究人员50余人参加了会议。

会上, 与会人员围绕Soc低功耗高性能电子器件、未来NAND FLASH 电荷捕获器件、高迁移率器件及物理、基于电阻开关的新一代非易失行存储器等内容展开了热烈的讨论和交流。创新团队负责人、“千人计划”学者朱慧珑博士还带领创新团队成员及专家参观了微电子所实验室并详细介绍了装备状况。

[打印本页](#)[关闭本页](#)